

Dienstleistungen und aktuelle Prüfverfahren des Prüflabors

Das Prüflaboratorium

„EMVCo- und DK-Prüflabor“ bei der S-Payment GmbH

besitzt die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Software Tests und elektrische Tests von unpersonalisierten Chipkarten mit Betriebssystem SECCOS zur Erlangung einer

A. DK Modulzulassung

B. EMVCo Card Type Approval

durchzuführen.

Die nachfolgend aufgeführten Prüfverfahren sind auf aktuellem Stand und werden hiermit veröffentlicht.

A. DK Modulzulassung

Im Rahmen der im DK Zulassungsverfahren sog. „Funktionstests“ wird durch das Berichten des Prüfungsvorgangs „DK Testsuite 1“ eine „DK Modulzulassung“ erlangt und von der DK Zulassungsstelle erteilt.¹

Der Prüfungsvorgang „DK Testsuite 1“ besteht aus einem Prüfverfahren:

Titel des Prüfverfahrens:	DK Testsuite 1 - Software Tests
Version des Prüfverfahrens:	2.3
Kurzbeschreibung des Prüfverfahrens:	Gemäß DK Anforderungen werden Tests über die kontaktbehaftete und ggf. kontaktlose Schnittstelle durchgeführt. Umfang der Tests sind: • Standard- und Ergänzungskommandos und Kommandoübergreifende Tests • Test der bidirektionalen kontaktbehafteten Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=1 • Test der bidirektionalen kontaktlosen Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=CL • Test eines konsistenten Datenzustands bei einem Kommunikationsabbruch mit dem Terminal
Anforderungen an den Prüfgegenstand:	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt und unterstützt mind. die kontaktbehaftete Schnittstelle.
DK Spezifikationsgrundlage¹:	1. Interface Specifications for the SECCOS ICC, Secure Chip Card Operating System (SECCOS), Version 7.1 08.07.2014 <u>oder</u> Version 7.2 20.02.2024 2. Interface Specifications for the SECCOS ICC, Updates to Secure Chip Card Operating System (SECCOS), 05.04.2022 3. Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Datenstrukturen und Kommandos Nachladen von Programmcode, Version 1.0 01.12.1999 4. Interface Specifications for the SECCOS ICC, EMV Commands and SECCOS EMV Applications, Version 3.5 22.06.2021 <u>oder</u> Version 3.6 20.02.2024 5. Schnittstellenspezifikation für die SECCOS-Chipkarte, GeldKarte, Applikation elektronische Geldbörse (mit Ergänzungen zum Laden und Bezahlen über die kontaktlose Schnittstelle), Version 1.3 21.03.2011 <u>oder</u> Version 2.1 10.02.2017
Testsuite:	In der sog. „ZKA Testsuite“ wird die Umsetzung der für den Prüfgegenstand zutreffenden DK Spezifikationsgrundlage geprüft.
Version der Testsuite:	v7.1.402

¹ siehe <https://die-dk.de/zahlungsverkehr/zulassungsverfahren/chip-zulassungsverfahren/>

B. EMVCo Card Type Approval

Im Rahmen der im EMVCo Zulassungsverfahren sog. „*Card Functional Evaluation*“ wird durch das Berichten der Prüfvorgänge „*EMVCo Level 1 electrical and Protocol Testing*“ und „*EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing*“ eine „*EMVCo Card Type Approval*“ erlangt und von der EMVCo Zulassungsstelle erteilt.²

Der Prüfvorgang „EMVCo Level 1 electrical and Protocol Testing“ setzt sich aus zwei Prüfverfahren zusammen:

Titel des Prüfverfahrens:	EMVCo Level 1 -electrical Testing
Version des Prüfverfahrens:	2.1
Kurzbeschreibung des Prüfverfahrens:	Gemäß EMV Anforderungen werden kontaktbehaftete Tests der elektrischen Eigenschaften der Chipkarte bei vorgegebenen Klimawerten (Temperatur, Luftfeuchte) durchgeführt.
Anforderungen an den Prüfgegenstand:	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Specification Bulletins umgesetzt und unterstützt die kontaktbehaftete Schnittstelle.
EMVCo Testspezifikationen:	1. EMV Contact Card Level 1 Type Approval ICC Electrical Test Cases, Version 1.0a December 2023 2. EMV Card Type Approval CCD Level 1 and Level 2 Card Images Requirements, Version 4.3.f February 2019 3. EMV Card Type Approval CPA Level 1 and Level 2 Card Images Requirements, Version 1.0.m February 2019 4. Card Type Approval: Communication No. 25, Guideline for Card Level 1 Electrical Test Case 1SB.015, 4th Edition December 2023 5. Guidelines for MP300-TC3, Version 1.4 6. Scope for the Testing EMVCo Card Level 1 of Seccos Cards, Version 1.10 25.01.2024
Testsuite:	In der sog. „EMVeriCard“ Testsuite sind die EMVCo Testspezifikationen abgebildet. Die Testsuite in aktueller Version ist von EMVCo qualifiziert.
Version der Testsuite:	v3.4.2

² siehe <https://www.emvco.com/processes-forms/product-approval/card/cpa/>

Titel des Prüfverfahrens:	EMVCo Level 1 -Protocol Testing
Version des Prüfverfahrens:	2.1
Kurzbeschreibung des Prüfverfahrens:	Gemäß EMV Anforderungen werden Tests der bidirektionalen kontaktbehafteten Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=1 bei vorgegebenen Klimawerten (Temperatur, Luftfeuchte) durchgeführt.
Anforderungen an den Prüfgegenstand:	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Specification Bulletins umgesetzt und unterstützt die kontaktbehaftete Schnittstelle.
EMVCo Testspezifikationen:	1. EMV Contact Card Level 1 Type Approval ICC Protocol Test Cases, Version 1.0a December 2023 2. EMV Card Type Approval CCD Level 1 and Level 2 Card Images Requirements, Version 4.3.f February 2019 3. EMV Card Type Approval CPA Level 1 and Level 2 Card Images Requirements, Version 1.0.m February 2019 4. Guidelines for MP300-TC3, Version 1.4 5. Scope for the Testing EMVCo Card Level 1 of Seccos Cards, Version 1.10 25.01.2024
Testsuite:	In der sog. „EMVeriCard“ Testsuite sind die EMVCo Testspezifikationen abgebildet. Die Testsuite in aktueller Version ist von EMVCo qualifiziert.
Version der Testsuite:	1.0a_R3

Der Prüfvorgang „EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing“ besteht aus einem Prüfverfahren:

Titel des Prüfverfahrens:	EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing
Version des Prüfverfahrens:	2.3
Kurzbeschreibung des Prüfverfahrens:	Gemäß EMV Anforderungen werden kontaktbehaftete CPA/CCD Tests von Standard- und Ergänzungskommandos und Kommandoübergreifende Tests durchgeführt.
Anforderungen an den Prüfgegenstand:	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Specification Bulletins umgesetzt und unterstützt die kontaktbehaftete Schnittstelle.
EMVCo Testspezifikationen:	1. EMV Card Type Approval CCD Level 2 Test Cases, Version 4.4a October 2023 2. EMV Card Type Approval CPA Level 2 Test Cases, Version 1.0.o Part A April 2024 & Version 1.0.o2 Part B May 2025 3. EMV Card Type Approval CCD Level 1 and Level 2 Card Images Requirements, Version 4.4.a September 2024 4. EMV Card Type Approval CPA Level 1 and Level 2 Card Images Requirements, Version 1.0.o September 2024 5. Scope for the Testing EMVCo Card Level 2 of SECCOS Cards, Version 1.0.o 30.04.2024
Testsuite:	In der sog. „ZKA TestSuite EMV“ sind die EMVCo Testspezifikationen abgebildet. Die Testsuite in aktueller Version ist von EMVCo qualifiziert.
Version der Testsuite:	v1.11.1

Verwendete Abkürzungen

CCD	Common Core Definition
CPA	Common Payment Application
DAkKS	Deutsche Akkreditierungsstelle
DK	Die Deutsche Kreditwirtschaft
EA	European Accreditation
EMV	Eine Spezifikation für Zahlungskarten der drei namensgebenden Gesellschaften Europay (jetzt MasterCard Europe), MasterCard und Visa.
SECCOS	Secure Chip Card Operating System
ZKA	Zentraler Kreditausschuss (wurde namentlich durch DK ersetzt)

Definitionen

DK	Die Deutsche Kreditwirtschaft vertritt die Interessen der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände in Deutschland, siehe www.die-dk.de .
EMVCo	EMVCo ist eine Evaluierungseinrichtung, welche von diversen internationalen Payment Systems gegründet wurde und gemeinsam betrieben wird, siehe www.emvco.com .